

概要

テイサンレジンとは弊社のラジカル重合技術を基にしたアクリル酸エステル共重合体の総称です。
 シャープな分子量分布を持つポリマーが得られる懸濁重合法を、難易度の高い比較的低 T_g（ガラス転移温度）のエラストマー製造に工業的に適用する技術力をベースとして開発した高機能性ポリマー製品です。
 カルボキシル基、水酸基、エポキシ基等の官能基を有する各種製品をラインナップしており、これら製品は表面保護フィルム用粘着剤、電子材料用粘着剤材料などの高機能・高付加価値製品に幅広くご使用頂いております。
 また、ご要望に応じたポリマー設計を行なうことで、様々な用途に適した開発品を供給させて頂くことが可能です。

特徴

- 溶液重合や乳化重合によるポリマーと比較して、分子量分布が狭く、残存モノマーの少ないポリマーです。
 また、高分子量ポリマーも得ることが可能であり、分子量の制御も可能です。
- 乳化重合の際に使用する様な界面活性剤を使用しませんので、不純物の少ないポリマーです。
- 比較的低 T_g（約-30℃～室温）のポリマーであっても工業的に製造可能です。
- ポリマー主鎖は飽和結合であり、酸化劣化、加熱老化による接着強度の低下が少なく、高い信頼性を有します。
- 官能基（COOH 基、OH 基等）の導入と共に、架橋剤（イソシアネート系、エポキシ系）を併用することで、接着性の改善、皮膜強度の向上を図る事が可能です。
- 用途や求められる特性に応じたポリマー設計を行ない、ご相談の上、開発品をご提案致します。

製品ラインナップ

製品名	官能基	溶媒	固形分 (%)	粘度 (mPa·s)	分子量 Mw (× 10 ⁴)	その他	理論 T _g (°C)	化審法登録
SG-70L	COOH OH	トルエン MEK	12.5	1,600	90	酸価 5 mgKOH/g	-13	有
SG-708-6	COOH OH	MEK	20	5,000	70	酸価 9 mgKOH/g	4	有
WS-023 EK30	COOH OH	MEK	30	6,000	50	酸価 20 mgKOH/g	-10	有
SG-P3	エポキシ	MEK	15	6,000	85	エポキシ価 0.21 eq/kg	12	有
SG-80H	エポキシ アミド	MEK	18	1,000	35	エポキシ価 0.07 eq/kg	11	有
SG-280 EK23	COOH	MEK	23	14,000	90	酸価 30 mgKOH/g	-29	有
SG-600TEA	OH	トルエン 酢酸エチル	15	5,000	120	水酸基価 20 mgKOH/g	-37	有
SG-790	OH	トルエン 酢酸エチル	23	1,300	50	水酸基価 40 mgKOH/g	-32	有

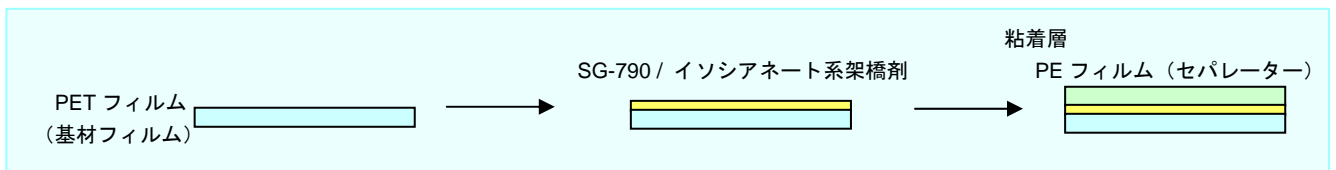
・上記データは、代表値であり、保証値ではありません
 ・ご使用の際は MSDS（製品安全データシート）をご確認の上、安全にご使用下さい
 ・本資料の内容は改良のため予告なく変更することがございますこと御了承ください

用途例

■ 保護フィルム

推奨グレード **SG-600TEA、SG-790** → 官能基：OH
SG-280EK23 → 官能基：COOH

高分子量（Mw 50 万～）かつ分子量分布が狭い為、低分子量成分が少ない → 剥離時の糊残りが少ない
 ポリマー主鎖が飽和結合である → 酸化劣化、加熱老化による接着強度の低下が少ない

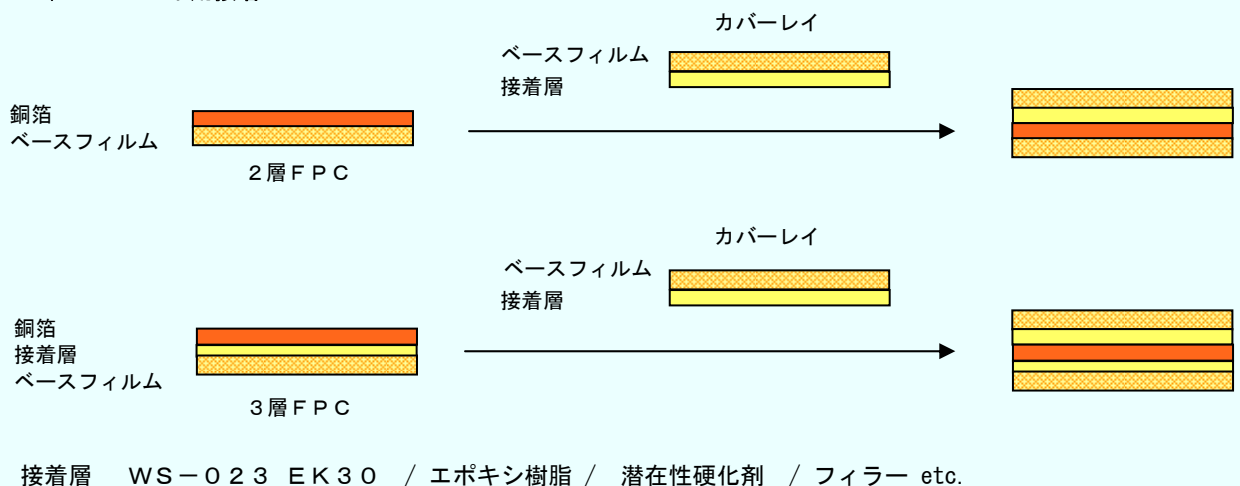


■ 電子材料用粘接着剤・樹脂改質(可とう性付与)

推奨グレード **SG-70L、SG-708-6、WS-023 EK30** → 官能基：COOH、OH
SG-P3 → 官能基：エポキシ
SG-80H → 官能基：エポキシ、アミド

高分子量（Mw 35 万～）かつ分子量分布が狭い為、低分子量成分が少ない → 高い凝集力と接着信頼性
 ポリマー主鎖が飽和結合である → 加熱老化による接着強度の低下が少ない
 イオン性不純物が少ない → 高い絶縁信頼性

FCCL、カバーレイ用接着シート



ご紹介しました使用例につきましては、本製品の適用結果を保証するものではありません。ご使用に際しましては、用途、使用目的への適合性をご評価頂けますようお願い致します。また工業所有権などにもご注意ください。